

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Схема процесса подготовки медной поверхности печатных плат MecEtchBond**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительная очистка****MEKLEEN MAC-5330**Обезжиривание (опция) | Температура 20 - 30 ° С (стандарт 35 ° C)Время погружения: 10-30 секДавление распыления: 0,1 – 0,3 MPa Время обработки: 15 сек |
| промывка водой(3 ступени) |
| **Микротравление CZ-8100** | Температура 30 - 40 ° С (стандарт 35 ° C)Давление распыления: 1 - 2 кг / см²Скорость травления: прибл. 0,7 (до 4 мкм) Время обработки: 25-90 сек. |
|  | Промывка водой |
| **Кислотная промывка**10,0% объем, 35% р-р **HC**l Удаление шлама | Температура 20 - 30 ° СДавление распыления: 0,3-0,6 кг / см²Время: 10-15 сек. |
|  | Промывка водой(более 2 раз) |
| **Обработка от окисления CL-8300**Образование органической пленки (опция) | Погружать или распылять20 - 30 ° C Время:10 - 15 сек. |
|  | Промывка |
|  | Сушка |

Область применения процесса микротравления MecEtchBond практически не ограничены. Сочетание процессов **MecEtchBond 8100** и процессом **CL-8300** широко используется в качестве альтернативы технологии черного оксидирования меди, что дает высочайшие результаты по силе адгезии.

Адгезия меди со смолой увеличивается благодаря механическому сцеплению за счет микрорельефа поверхности меди и химического сцепления за счет образования химических связей между органическим слоем CL-8300 и смолой.